

安集微电子科技（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：安集科技                      股票代码：688019                      编号：2026-001

投资者关系 活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div>
参与单位名称	Ariose Capital Mgmt Ltd, Balyasny Asset Mgmt, BNP Paribas Asset Mgmt, Dymon Asia Capital HK Ltd, Franklin Templeton, Fullerton, GIC Pte Ltd, Greenwoods Asset Mgmt HK Ltd, GS, Helved Capital, Himension Capital (Singapore) Pte Ltd, INVESCO Asia Ltd - Hong Kong, Ishana Capital Ltd, Janchor Partners Ltd, Marshall Wace, MFS Inv Mgmt, Millennium Partners LP, Monolith Mgmt Ltd, More Capital, Morgan Stanley, Optimas Capital Ltd, Orient Secs Co Ltd, Pinpoint Asset Mgmt Ltd, Point72 Hong Kong Ltd, Polymer Capital Mgmt (HK) Ltd, Springs Capital, Temasek Intl Pte Ltd, Trivest, UG Funds, etc.
时间	2026 年 1 月 8 日
地点	公司会议室
公司 接待人员姓名	董事长 Shumin Wang 副总经理、董事会秘书 杨逊
投资者关系 活动 主要内容介绍	<p>一、公司介绍： 介绍公司经营业务及未来发展规划。</p> <p>二、问答环节主要内容：</p> <p><b>Q：与海外竞争对手相比，公司的主要优势体现在哪些方面？</b></p> <p><b>A：</b>公司在技术与服务两大维度上具备优势。技术上，公司拥有扎实的研发创新能力，部分关键技术已达到国际领先水平；服务上，公司注重协作与支持，响应快速，灵活度高，能够持续为客户提供高质量的定制化解决方案，更好地建立长期稳定的合作关系。</p>

**Q：公司海外业务及布局是否有受地缘政治的影响？**

A：公司始终以“立足中国、服务全球”为核心战略定位。尽管地缘政治环境对出海企业带来挑战，但整体情况来看，公司在海外地区的客户数量和项目推进未受影响，客户关注度和合作兴趣依然积极，海外布局稳步推进。

**Q：随着芯片先进制程的进步，对贵司 CMP 抛光液的产品需求有影响吗？**

A：随着芯片制程进步，芯片中多层布线数量与密度上升，CMP 工艺步骤随之增多，带动抛光液消耗量增加；同时，先进制程往往需要抛光新的材料类型，这也为抛光液产品带来新的市场机会。在存储芯片领域，技术从 2D NAND 向 3D NAND 等结构演进，同样增加了 CMP 工艺步骤，推动对 CMP 抛光材料的需求。因此，先进制程的进步有望持续推动我司 CMP 抛光液产品需求的增长。

**Q：公司已布局光刻胶剥离液产品，未来是否有计划进入光刻胶领域？**

A：公司自成立之初持续专注在液体与固体衬底表面之间的微观作用的核心技术平台，产品聚焦在化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂三大板块以及关键上游原材料。其中，您所提及的光刻胶剥离液属于公司功能性湿电子化学品业务范围。截至目前，公司尚无开展光刻胶产品研发或生产的计划。

**Q：公司未来 2-3 年，增长驱动主要有哪些？**

A：首先是受益于半导体产业的长期发展趋势，半导体材料市场规模保持增长态势，且随着先进逻辑芯片、3D 存储芯片及异构集成技术的工艺步骤增加，带动晶圆制造与封装材料需求持续提升；同时，客户产能扩张及国产化替代进程的加快，也将促进公司产品需求的增长。在内部驱动方面，公司积极拓展国际市场，努力进入全球主流半导体供应链，并持续加强研发投入，推动产品迭代与性能提升，通过产品性能提升及品类的拓展进一步提升公司核心产品的市场份额。内外部因素的协同作用，共同为公司的稳健增长提供支撑。

**Q：公司对于兼并收购的战略和想法是怎样的？**

	<p>A：公司对兼并收购秉持开放、聚焦、审慎的态度。我们主要遵循两大核心原则：一是着重增强技术协同性及业务差异化能力，二是注重收购标的与公司文化和价值理念的高度契合。在此框架下，公司将基于实际发展阶段与战略需求，依托现有业务与技术积累，持续通过战略投资并购或建立商业合作关系等多元方式，稳健推进境内外产业链的整合与布局，拓宽业务领域，提升技术实力，布局资产多元化，寻求积极、稳健的外延式增长。</p> <p><b>Q：公司海外业务的占比情况如何？</b></p> <p>A：现阶段公司海外业务在绝对金额上保持增长，由于国内业务增速更为快速，公司整体销售收入在增加，故造成海外收入占比有所下降。</p>
附件清单 （如有）	无
日期	2026 年 1 月 9 日